产品数据表

晶圆凸块助焊剂 SC 5R

特点

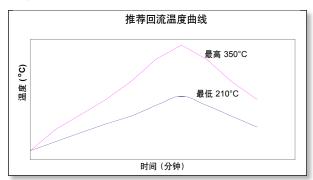
- 无卤化物
- 氮气回流环境

5R 是用于各种金属与合金的热稳定松香助焊剂,具有宽松的工艺温度窗口,从125℃至350℃。电镀沉积形成光亮的球形焊点凸起。可用于浸渍、喷涂和旋转涂层并 适合于锡/铅和无铅合金。

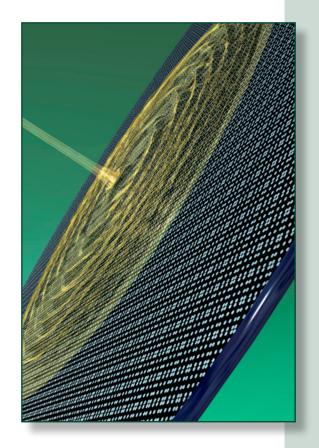
典型特性(未固化)

77至18日(76日16)	
典型粘度	37 厘沲 (cst)
闪点	11°C
助焊剂类型等级	ROLO
固态成分	47%
表观	琥珀色液体
萃取水电阻 (Ω-cm)	>100,000
回流环境	氮气

回流



这是5R 的标准回流温度曲线。到达峰值的时间约为 $3 \ge 5$ 分钟。峰值温度应高出金属熔点20°C。液相曲线以上的时间约为 $40 \ge 70$ 秒。



助焊剂残留物无腐蚀性、无导电性、无吸湿性。可用商业 助焊剂去除剂清洁。

液体助焊剂标准包装为1美制品脱(0.473公升)和1美制 加仑(3.785 公升) 容器。

储存与操作 5R在0 至 30°C温度下储存寿命为1年 助焊剂使用前应让其达到环境温度。

材料安全数据表

本产品MSDS 可上网

http://www.indium.com/techlibrary/msds.php查阅。

所有资料仅供参考。不得用作进货产品规格。

此资料只是一般信息。不能保证或担保这些资料所述产品的性 能,也不可以把这些资料看作是对所述产品的保证或担保。

售出的产品只承诺随产品包装及发票所附的书面保证及有关的限 制条件。

表格编号98206(SC A4) R0

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com china@indium.com 中国+86 (0)512 628 34900 新加坡 +65 6268 8678 英国+44 (0) 1908 580400 美国+1 315 853 4900



